

京セラ株式会社 鹿児島川内工場

(電子部品・デバイス・電子回路製造業)

(薩摩川内市)

温室効果ガス排出量削減に向けた取り組み・社会貢献活動

京セラグループでは、気候変動問題を重要な経営課題のひとつとして位置づけています。長期環境目標の設定や再生可能エネルギーの積極的な導入、情報開示の充実に取り組むことで、CO2をはじめとする温室効果ガスの削減を推進しています。鹿児島川内工場では、情報通信／データセンサー／自動車の自動運転などに必要不可欠な半導体や電子部品を保護するためのパッケージを製造しています。人類社会が大きく飛躍発展するために欠かせない新たな製品群を次々に製造し続ける、創造型未来企業です。



工場長 重田 幸男

会社概要

2021年4月1日現在

■所在地

〒895-0292

鹿児島県薩摩川内市

高城町1810

■TEL

0996-23-4121

■FAX

0996-23-4127

■E-Mail

■URL

<https://www.kyocera.co.jp>

■代表者

工場長

重田 幸男

■設立

1959年4月1日

■資本金

115,703百万円

■従業員数

78,490名(川内工場:4,368名)

■事業概要

セラミックス製品・通信機器・半導体部品

■主要製品

電子工業用部品・セラミック多層パッケージ・有機多層パッケージ・工業用精密ナイフ

ファインセラミック部品・セラミック応用商品

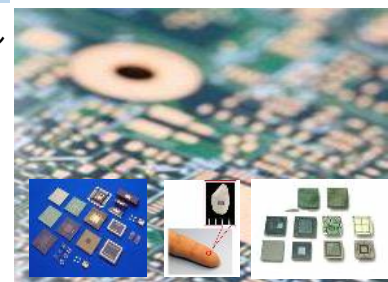
高純度に精製・合成された原料を用い、高度に制御された環境において高温で焼き上げることにより生まれるファインセラミックス。テレビのブラウン管に使用されるU字ケルシマ管から始まりその後、電気機器・デバイス用部品に代表される電子工業用部品や産業用機械部品、情報機器関連部品、装飾部品とセラミックスのもつ特性を活かし、その用途を広げてきました。ファインセラミックスは私たちの生活を楽しく快適にする生活用品のアイテムにも活かされています。京セラのセラミック包丁は、その強度と破壊靱性を兼ね備えた材料の開発、シミュレーション技術を活用して、欠け難い形状をデザインしています。



電子工場用・産業用機械部品／応用商品

半導体用セラミックパッケージ・半導体用有機パッケージ

多機能化、高性能化を続ける携帯電話、デジタル家電、情報機器、また自動車のエレクトロニクス化、自動運転技術の進化など、セラミックパッケージはICの発展に合わせて進化してきました。技術展開のキーポイントは、複数層のセラミックシートを積層することによる多層化にあり、小型化、多ピン化、受動部品を内蔵することによる多機能化を実現しています。また、近年では水晶デバイスなどの電子部品用として、超小型化・中空封止構造が求められるため、壁厚を薄型化する高強度材料の開発、強度計算シミュレーション技術を駆使して開発を進めています。



セラミック多層・有機多層パッケージ

機械工具

機械工具は、切削工具事業から空圧工具・電動工具事業まで、総合機械工具メーカーとして幅広い市場に対応しており、川内工場は、グローバルに展開する切削工具事業のマザープラントとして、『切削工具』『工業用ナイフ/耐熱・耐摩耗部品』の開発・製造を行っています。耐摩耗性に優れる素材 ファインセラミックス、超硬合金、サーメットなどの材料開発とコーティング技術から生まれた独自の切削工具は、自動車産業、建設機械、造船業、航空機産業の金属加工の現場で重切削から精密加工まで、さまざまなプロセスで生産性向上に貢献しています。



工業用精密ナイフ・切削工具